

ESPRIMO™ P Green PC Ihr täglicher Business Performer

Ausgabe April 2008

Seiten 7

Stellen Sie maximale Leistung auf Ihrem Schreibtisch. Dank der reichhaltigen Auswahl an Technologie und dem langen Lebenszyklus von bis zu 18 Monaten ist der ESPRIMO P die beste Wahl für Kunden, die einen qualitativ hochwertigen Mikrotower benötigen.

ESPRIMO Professional PCs werden aus ausgewählten Materialien hergestellt, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Bereits bei der Produktentwicklung wird die Umweltverträglichkeit über den gesamten Produktlebenszyklus berücksichtigt und optimiert. ESPRIMO Professional PCs erfüllen neben den gesetzlichen Anforderungen viele weitergehende nationale und internationale Umweltstandards in den Bereichen der Produktentwicklung, Produktion, Gebrauch, Transport und Recycling.

Komfortables Arbeiten mit der ESPRIMO P Plattform: Ergonomisch, leise und zuverlässig. Die Administration ist einfach und sicher. Verschiedene Produktspezifikationen des ESPRIMO P erlauben die Integration in die gängige Büroarbeitsumgebung. Zusammengefasst: Diese höchst zuverlässige Plattform lässt sich spezifisch an Ihre Business Anforderungen anpassen.

Zuverlässigkeit

- Erstklassige Fertigung. Ausgezeichnet mit dem Bayerischen Qualitätspreis 2006
- Hohe Qualität und funktionelle Stabilität durch eigene Entwicklung und Fertigung
- Kurze Antwort- und Lieferzeiten
- Verschiedene Logistikkonzepte für zeitgerechte und maßgeschneiderte Lieferung: value4you, made4you
- Garantie, Services und Ersatzteilversorgung gemäß Ihren Bedürfnissen

Manageability

- Umfangreiche Verwaltungsfunktionen auf Basis von DeskView Client Management
- DeskView Migrate, Control: Optionale Softwarepakete für optimale Integration der Systeme in Ihre IT Umgebung

Security

- Zugangs- und Datenschutz mit ausgefeilten Hardware und Softwarekomponenten

Kundenspezifische Fertigung

- Vollständig konfigurierbar: Prozessor, Arbeitsspeicher, Laufwerke, Zusatzkarten
- Individuelle Auswahl an Hardware, Software und Design

Ergonomie

- Produkt- und Produktionskonzept für minimale Auswirkung auf die Umwelt
- Reduzierung von Ausfallzeiten durch servicefreundliches Gehäuse und einfachem Komponentenzugriff
- Stressfreies Arbeiten und leiser Betrieb dank niedriger Geräuschemission
- Blauer Engel – weil energiesparend und geräuscharm



www.wwf.de/computer



Foto: ESPRIMO P5625 / P5720 / P5925

	P5615	P5616	P5625	P5625 EPA	P5720	P5720, EPA	P5925 vPro™	P5925 vPro™, EPA
Mainboard								
Chipsatz	NVIDIA C51PV	NVIDIA C51PV	NVIDIA MCP78B	NVIDIA MCP78B	iQ33	iQ33	iQ35 vPro	iQ35 vPro
Mainboard	D2461-A	D2461-B TPM	D2721	D2721	D2581	D2581	D2584	D2584
Mainboard Formfaktor	µBTX	µBTX	µBTX	µBTX	µBTX	µBTX	µBTX	µBTX
Prozessorsocket	Socket AM2	Socket AM2	Socket AM2+	Socket AM2+	LGA 775	LGA 775	LGA 775	LGA 775
Front Side Bus / System Bus	2000 MHz	2000 MHz	4000 MHz	4000 MHz	800/1066/1333 MHz	800/1066/1333 MHz	800/1066/1333 MHz	800/1066/1333 MHz
BIOS	Phoenix V 6.0	Phoenix V 6.0	Phoenix V 6.0	Phoenix V 6.0	Phoenix V 6.0	Phoenix V 6.0	Phoenix V 6.0	Phoenix V 6.0
Flash EPROM BIOS Update per Software	x	x	x	x	x	x	x	x
Recovery BIOS	x	x	x	x	x	x	x	x
Prozessor								
Intel® Core™ 2 Quad Q9xxx	-	-	-	-	-	-	bis Q9450 (ca. 04/08)	bis Q9450 (ca. 04/08)
L2 Cache	-	-	-	-	-	-	6MB / 12MB	6MB / 12MB
Front Side Bus (FSB)	-	-	-	-	-	-	1333 MHz	1333 MHz
Intel® Core™ 2 Duo E8xxx	-	-	-	-	bis E8500	bis E8500	bis E8500	bis E8500
L2 Cache	-	-	-	-	6 MB	6 MB	6 MB	6 MB
Front Side Bus (FSB)	-	-	-	-	1333 MHz	1333 MHz	1333 MHz	1333 MHz
Intel® Core™ 2 Duo E6xxx	-	-	-	-	bis E6850	bis E6850	bis E6850	bis E6850
L2 Cache	-	-	-	-	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB
Front Side Bus (FSB)	-	-	-	-	1333 MHz	1333 MHz	1333 MHz	1333 MHz
Intel® Core™ 2 Duo E4xxx	-	-	-	-	bis E4600	bis E4600	bis E4600	bis E4600
L2 Cache	-	-	-	-	2 MB	2 MB	2 MB	2 MB
Front Side Bus (FSB)	-	-	-	-	800 MHz	800 MHz	800 MHz	800 MHz
Intel® Pentium™ Dual Core E2xxx	-	-	-	-	bis E2200	bis E2200	bis E2200	bis E2200
L2 Cache	-	-	-	-	1 MB	1 MB	1 MB	1 MB
Front Side Bus (FSB)	-	-	-	-	800 MHz	800 MHz	800 MHz	800 MHz
Intel® Celeron	-	-	-	-	bis 440	bis 440	bis 440	bis 440
L2 Cache	-	-	-	-	512 KB	512 KB	512 KB	512 KB
Front Side Bus (FSB)	-	-	-	-	800 MHz	800 MHz	800 MHz	800 MHz
Phenom™ Quad Core (Socket)	-	-	bis 9550 (AM2+)	-	-	-	-	-
L2 Cache	-	-	2 MB	-	-	-	-	-
L3 Cache	-	-	2 MB	-	-	-	-	-
System Bus Unterstützung	-	-	3600 MHz	-	-	-	-	-
Phenom™ Triple Core (Socket)	-	-	bis 8450 (AM2+)	-	-	-	-	-
L2 Cache	-	-	1,5 MB	-	-	-	-	-
L3 Cache	-	-	2 MB	-	-	-	-	-
System Bus Unterstützung	-	-	3200 MHz	-	-	-	-	-
Athlon™ 64 X2 Dual Core (Socket)	-	-	bis 5600+ (AM2)	bis 5600+ (AM2)	-	-	-	-
L2 Cache	-	-	bis 2 MB	bis 2 MB	-	-	-	-
L3 Cache	-	-	-	-	-	-	-	-
System Bus Unterstützung	-	-	2000 MHz	2000 MHz	-	-	-	-
Athlon™ Dual Core (Socket) Energieeffizient	-	-	4450e (AM2)	4450e (AM2)	-	-	-	-
L2 Cache	-	-	1 MB	1 MB	-	-	-	-
L3 Cache	-	-	-	-	-	-	-	-
System Bus Unterstützung	-	-	2000 MHz	2000 MHz	-	-	-	-
Athlon™ Single Core (Socket) Energieeffizient	-	-	LE-1640 (AM2)	LE-1640 (AM2)	-	-	-	-
L2 Cache	-	-	512 MB	512 MB	-	-	-	-
L3 Cache	-	-	-	-	-	-	-	-
System Bus Unterstützung	-	-	2000 MHz	2000 MHz	-	-	-	-
Sempron™ Single Core (Socket) Energieeffizient	-	-	LE-1250 (AM2)	LE-1250 (AM2)	-	-	-	-
L2 Cache	-	-	512 KB	512 KB	-	-	-	-
L3 Cache	-	-	-	-	-	-	-	-
System Bus Unterstützung	-	-	1600 MHz	1600 MHz	-	-	-	-
AMD Athlon™ 64 X2 (Socket)	bis 5200+ (AM2)	bis 5200+ (AM2)	-	-	-	-	-	-
L2 Cache	2 x 512 KB	2 x 512 KB	-	-	-	-	-	-
System Bus Unterstützung	2000 MHz	2000 MHz	-	-	-	-	-	-
AMD Athlon™ 64 (Socket)	3800+ (AM2)	3800+ (AM2)	-	-	-	-	-	-
L2 Cache	512 KB	512 KB	-	-	-	-	-	-
System Bus Unterstützung	2000 MHz	2000 MHz	-	-	-	-	-	-
AMD Sempron™ (Socket)	3600+ (AM2)	3600+ (AM2)	-	-	-	-	-	-
L2 Cache	256 KB	256 KB	-	-	-	-	-	-
System Bus Unterstützung	1600 MHz	1600 MHz	-	-	-	-	-	-
AMD Athlon™ X2 (Socket) Energieeffizient	BE-2350 (AM2)	BE-2350 (AM2)	-	-	-	-	-	-
L2 Cache	2x 512 KB	2x 512 KB	-	-	-	-	-	-
System Bus Unterstützung	2000 MHz	2000 MHz	-	-	-	-	-	-

	P5615	P5616	P5625	P5625 EPA	P5720	P5720, EPA	P5925 vPro™	P5925 vPro™, EPA
Kompatibilität (Referenzen)								
Microsoft Betriebssysteme (HCT / HCL Eintrag)	x	x	x	x	x	x	x	x
PC 2001, DMI 2.0, WMI 1.5, USB 2.0	x	x	x	x	x	x	x	x
Manageability								
ASF 2.0 (Alert Standard Format)	-	-	x	x	x	x	x	x
iAMT 2.x (Intel Active Management Technology). Nicht aktiviert oder provisioniert. Nur für Windows XP und Vista Business	-	-	-	-	-	-	x (v. 3.0)	x (v. 3.0)
DeskView 10.x Client Management inklusive:								
On / Offline Remote Client Mgt.	x	x	x	x	x	x	x	x
System Inventarisierung & Reporting	x	x	x	x	x	x	x	x
BIOS Management	x	x	x	x	x	x	x	x
Remote Power Management	x	x	x	x	x	x	x	x
Nachrichten der Systemüberwachung	x	x	x	x	x	x	x	x
Umfangreiche Alarmer (mit ASF)	-	-	-	-	x	x	x	x
Security Remote Control	x	x	x	x	x	x	x	x
DeskView Helpdesk Integration	x	x	x	x	x	x	x	x
DeskUpdate Treiber Management	x	x	x	x	x	x	x	x
DeskView Migrate	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
DeskView Control	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
PXE 2.1 Bootcode	x	x	x	x	x	x	x	x
BootP Bootcode inclusive								
BootManage Administrator SW	getestet	getestet	getestet	getestet	getestet	getestet	getestet	getestet
Wake up aus S5 Modus (Off)	x	x	x	x	x	x	x	x
Intrusion Detection Schalter	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Sicherheit								
<i>Sicherheitsfunktionen im Gehäuse</i>								
Vorbereitet für Kensingtonschloss, Öse für Vorhängeschloss, Verplömbungsmöglichkeit	x	x	x	x	x	x	x	x
Integriertes Gehäuseschloss	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
<i>Systemicherheit</i>								
Bootsektor Virenschutz	x	x	x	x	x	x	x	x
Schreibschutzoption für Flash EPROM	x	x	x	x	x	x	x	x
Embedded Security (TPM1.2)	-	Infineon	Infineon	Infineon	Infineon	Infineon	Infineon	Infineon
Kontrolle aller USB Schnittstellen / nur der externen USB Schnittstellen	x / -	x / -	x / -	x / -	x / x	x / x	x / x	x / x
Bootschutz für Floppy- / CD, Schreibschutz für Floppy	x	x	x	x	x	x	x	x
Kontrolle der externen Schnittstellen	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Benutzersicherheit</i>								
Setup / System BIOS-Passwort	x	x	x	x	x	x	x	x
SystemLock 2 BIOS SmartCard Security	x	x	x	x	x	x	x	x
Festplattenpasswort	x	x	x	x	x	x	x	x
Zugriffsschutz durch externen Chipkartenleser	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Zugriffsschutz durch internen Chipkartenleser	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Serviceability								
FlexySlot	x	x	x	x	x	x	x	x
EasyFix	x	x	x	x	x	x	x	x
EasyChange (HDD / opt. LW)	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x	x / x
EasyPull	x	x	x	x	x	x	x	x
Verpackungsinformationen								
Umverpackung (H x B x T) mm	500 x 290 x 540	500 x 290 x 540	500 x 290 x 540	500 x 290 x 540	500 x 290 x 540	500 x 290 x 540	500 x 290 x 540	500 x 290 x 540
Maximale Anzahl von Systemen pro Palette	24	24	24	24	24	24	24	24
Material / Gewicht in Gramm								
Kartonage	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270
EPS / PS	210	210	210	210	210	210	210	210
PE	ca. 60	ca. 60	ca. 60	ca. 60	ca. 60	ca. 60	ca. 60	ca. 60
Benutzerdokumentation auf chlorfrei gebleichtem Papier								

Recycling Informationen / Rücknahmeinformationen

Vorstehende Produkte wurden für einfache Wiederverwertung entwickelt. Informationen bezüglich Rücknahme und Recycling finden Sie hier <http://www.fujitsu-siemens.de/recycling>

Informationen über unsere Umweltprogramme, Richtlinien und Ziele
<http://www.fujitsu-siemens.de/aboutus>

Materialhinweise

Stoffverbotsliste gemäß Richtlinie (FSC 03230) „Umweltgerechte Produktgestaltung und -entwicklung“
 Vorstehende Daten reflektieren Labormessungen. Kundenkonfigurationen können aufgrund anderer Software, Komponenten und Peripheriegeräten abweichen.

Integriertes Umweltschutzkonzept über den gesamten Produktlebenszyklus

Entwicklung

- **Ökologische Konstruktionsrichtlinie:**
Basis unseres Umweltschutzkonzeptes ist die unternehmensweit verbindlich anzuwendende FSC Richtlinie (FSC 03230) „Umweltgerechte Produktgestaltung und –entwicklung. Diese definiert - über die gesetzlichen Vorgaben hinaus - ökologische Anforderungen über den gesamten Produktlebenszyklus, welche in der Designphase zu berücksichtigen sind. Somit werden bereits bis zu 80% der gesamten produkt-spezifischen Umweltauswirkungen optimiert.
- Integration von produktspezifischen Umweltchecks und -abnahmen in den Entwicklungsprozess

Material

- Halogenfreie Kunststoff-Formteile und Gehäusekunststoffe
- Bleifreies Leiterplattenmaterial für Mainboard, Riser Karte und Stromversorgung (RoHS konform)
- Bleieintrag beim Mainboard lediglich durch nicht bleifrei verfügbare Komponenten (RoHS konform)
- Reduktion der Halogene für die Leiterplatten (Mainboard, Riser Karte, Stromversorgung): Verringerung der Chlor- und Bromanteile von ca. 12% - 15% auf unter 0,15 % gemäß dem globalen Standard JPCA-ES-OA-1999

Produktion

- Eigene Mainboardfertigung mit modernster Löttechnologie
 - Bleifreie Lotpasten
 - Löten unter Stickstoff-Atmosphäre
 - Flussmittel auf wasserlöslicher Basis
- Geringer Wasserverbrauch
 - Kein Waschen der Mainboards nach dem Löten
 - Wasser-Kreislauf-Führung für die Reinigung der Produktionsmittel
- Vermeidung von Gefahrstoffen in der Produktion
 - Kein Reinigen der PC-Gehäuse vor dem Verpacken
 - Reduzierung der zu entsorgenden Abfälle
- Verpackungsvorschriften für Zulieferteile
- Produktion gemäß ISO14001 zertifiziert – der internationale Standard für Umweltmanagement

Produktnutzung

- Besonders niedrige Geräusentwicklung
 - Silent PC durch Lüfterregelung und Thermal Management
 - Silent PC per patentierter Lüftersteuerung
 - Geräuscharme Festplatten
 - Messung der Geräuschemission mit CD/DVD Betrieb
- Hohe Energieeffizienz
 - Energiesparen mit ACPI / IA-PC (Instantly available PC)
 - Separater Netzschalter (Aus-Schalter) in der Stromversorgung des ESPRIMO C
 - Stromversorgung mit geschaltetem Monitorausgang (ausgewählte Modelle)
- Langlebig und servicefreundlich
 - Öffnen des Gehäuses ohne Werkzeug
 - Viele Komponenten ohne Werkzeug zu entnehmen
 - Modulbauweise
 - Einfache Systemerweiterung

Transport

- Chargenlieferungen, wieder verwendbare Transportverpackungen und recyclinggerechte Kartonagen helfen wertvolle Ressourcen zu sparen
- Großkundenverpackungen für Projekte (keine Einzelverpackungen)
- Weniger Transportvolumen durch Verpackungsoptimierung in der gesamten Inbound / Outbound-Logistik

Recycling

- Hohe Recyclingfähigkeit der Produkte (> 90%)
- Leichte Demontage
- Alle Systeme werden bei Fujitsu Siemens Computers fachgerecht recycled:
www.fujitsu-siemens.de/wvm

Umweltauszeichnungen und –Kooperationen

- Kooperation mit dem WWF Deutschland:
www.wwf.de/computer
- Blauer Engel – RAL UZ78 konform
www.blauer-engel.de